

证券代码：871981

证券简称：晶赛科技

公告编号：2024-002

安徽晶赛科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、投资者关系活动类别

特定对象调研

业绩说明会

媒体采访

现场参观

新闻发布会

分析师会议

路演活动

其他（网络会议）

二、投资者关系活动情况

活动时间：2024年2月1日下午15:30-17:00

活动地点：合肥市经济技术开发区云谷路2569号公司会议室

参与单位及人员：东方财富证券研究所

上市公司接待人员：公司董事、董事会秘书侯雪女士

三、投资者关系活动主要内容

本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下：

问题 1、请说明一下公司的业务分类？

答复：公司的主要业务为石英晶振的生产研发销售及封装材料的生产研发销售。

其中石英晶振产品可分为有源晶振和无源晶振两大类，无源晶振包括兆赫兹级石英谐振器、千赫兹级的音叉晶振、热敏晶振等；有源晶振包括普通振荡器、温补振荡器、差分振荡器、实时时钟晶振（RTC）等。

封装材料产品主要包括石英晶振需要使用的可伐环、上盖、外壳等，及少量其他电子元器件用封装材料。

问题 2、晶振业务方面，有源晶振和无源晶振的占比约为多少，下游应用分别包括哪些？

答复：目前公司有源晶振收入占公司晶振业务收入比重约 8%左右，其余为无源晶振。无源晶振的应用范围较广，广泛应用于移动终端、物联网、汽车电子、智能家居、家用电器等领域，是一种基础的频率元器件。有源晶振与无源晶振的应用场景亦有重叠，其中如温补振荡器主要应用于对频率精准度要求较高的 GPS 定位、基站、手机等领域，差分振荡器主要应用于光模块等应用领域。

问题 3、请介绍下公司与芯片设计公司的合作模式。

答复：芯片设计公司会将设计好的芯片方案出售给终端的应用客户端，由于芯片需要与配套线路中的石英晶振等电子元器件配合方能实现相应功能，芯片设计公司在设计的过程中会将需要配套使用的晶振产品做好参数匹配，并将通过匹配的晶振品牌记录在方案中，通常下游的终端客户在采用该方案时会使用芯片方案中标注的品牌元器件。

问题 4、目前晶振行业的竞争格局，公司产能利用率，产品价格是否有触底反弹迹象？

从全球晶振市场来看，目前日系品牌仍主导车规等高端领域的产品应用市场，台系品牌在高端消费类领域占据主导地位，中国大陆的厂商正在从中低端消费类市场往

高端消费类市场进军的过程中。

目前公司晶振产品产能利用率约 80%，产品价格相对稳定，暂无明显的回升迹象，公司将通过改善产品结构、提高高端产品占比等方式改善盈利能力。

问题 5、公司光刻设备使用情况和后续的相关拓展

公司光刻设备目前主要用于生产音叉晶振的晶片，小尺寸晶振（1612 型号以下）及超高频晶振（一般指 100MHZ 以上）的晶片亦需要使用光刻技术制造。

四、备查文件目录

《安徽晶赛科技股份有限公司投资者关系活动记录表》。

安徽晶赛科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日